

LOW PRESSURE MOULDING und Spritzguss

Low Pressure Moulding:

Ein innovatives Niederdruck-Spritzgussverfahren, welches eine schnelle und kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Verkapselung oder zum Vergießen bietet.

Kunststoffspritzguss:

Ein Urform-Verfahren für verschiedenste Arten von Kunststoffen.

KUNDENSPEZIFISCH UMSPRITZTE KABELKONFEKTIONEN

Durch das Umspritzen von elektronischen Komponenten werden diese vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen geschützt. Gleichzeitig entsteht eine sichere Verbindung zwischen elektronischer Komponente und Leitung. Die Bauteile werden bei diesem Vorgang nicht beschädigt; die Kunststoffummantelung ist vergleichbar mit einer schützenden Hülle.

Dieses Verfahren eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, wobei die Materialeigenschaften der verwendeten Kunststoffe schier grenzenlos sind.

UMSPRITZUNG ETWA VON...

- Steckverbindern und Leitungen
- Mechanischen Komponenten und Gehäusen
- Elektronischen Bauteilen
- Platinen



UNSER ANGEBOT

- Realisierung von Kundenwünschen und individuellen Formen
- Konstruktion und Formenbau
- Herstellung von Prototypen bis hin zur Serie
- Sehr kurze Reaktions- und Lieferzeiten
- Alles aus kompletter In-House-Fertigung
- Wirtschaftliche Preise

MÖGLICHKEITEN

Low Pressure Moulding	Spritzguss
Einzel- oder Mehrkavitätenformen möglich	Multikavitätsformen als Standard
Kostengünstige Prototypen und effiziente Serienfertigung für kleine und mittlere Losgrößen	Geeignet für Großserienproduktion
Hohe Füllmengen bei moderaten Temperaturniveaus (kompatibel mit Elektronik)	Kleine Füllmengen mit harten Materialien (hohe Drücke und Temperaturen)
Realisierung kundenspezifischer Anforderungen	

LOW PRESSURE MOULDING and Injection Moulding

Low Pressure Moulding:

An innovative low pressure injection moulding process that provides a fast and cost effective alternative to conventional encapsulation or potting.

Injection Moulding:

A forming process for various types of plastics

CUSTOMER-SPECIFIC OVERMOULDED WIRING SYSTEMS

The encapsulation of electronic components protects them from environmental influences against moisture, dust dirt and vibration. At the same time, the encapsulation serves as a connection between the electronic component and the cable. The components are not damaged during this process; the plastic coating is similar to a sheath.

This process opens up a multitude of possible applications, especially because of the material properties used setting almost no limitation.

APPLICATIONS EXAMPLES

- Connectors and cables
- Mechanical components and housings
- Electronic components
- Circuit boards



BENEFITS

- Realization of customer requirements and individual designs
- Design and manufacturing of injection moulds
- Production from prototypes up to high volume series
- Very short reaction and delivery times
- Complete in-house toolchain
- Competitive pricing

OPTIONS

Low Pressure Moulding	Spritzguss
Single or multi cavity moulds possible	Multi cavity moulds as standard
Cost effective prototypes small and medium size production	Suitable for high volume production
High filling volumes at moderate temperature levels (compatible with electronics)	Small filling volumes with hard materials (high pressures and temperatures)
Realisation of customer requirements	